

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年4月30日(30.04.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/060266 A1

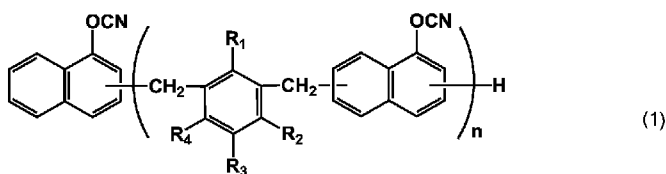
- (51) 国際特許分類:
C08L 65/00 (2006.01) C08K 5/29 (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01) C08K 5/315 (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01) C08L 63/00 (2006.01)
C08K 3/00 (2006.01) C08L 79/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/077870
- (22) 国際出願日: 2014年10月20日(20.10.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-222023 2013年10月25日(25.10.2013) JP
- (71) 出願人: 三菱瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 有井 健治(ARII, Kenji); 〒7128525 岡山県倉敷市水島海岸通3丁目10番地 三菱瓦斯化学株式会社 水島工場内 Okayama (JP). 小林 宇志(KOBAYASHI, Takashi); 〒1258601 東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 十亀 政伸(SOGAME, Masanobu); 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱瓦斯化学株式会社内 Tokyo (JP). 馬淵 義則(MABUCHI, Yoshinori); 〒1258601 東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 三島 裕之(MISHIMA, Hiroyuki); 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱瓦斯化学株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 稲葉 良幸, 外(INABA, Yoshiyuki et al.); 〒1066123 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階 TMI 総合法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: RESIN COMPOSITION, PREPREG, LAMINATED SHEET, AND METAL-FOIL-CLAD LAMINATED BOARD

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、プリプレグ、積層シート及び金属箔張り積層板



(57) Abstract: The present invention addresses the problem of providing a resin composition which enables the provision of a printed wiring board having low water absorbability and also having excellent heat resistance under moisture absorption, flame retardancy and solubility in solvents, and provides: a prepreg and a single-layer or laminated sheet each produced using the resin composition; and a metal-foil-clad laminated board, a printed wiring board and the like each produced using the prepreg. The resin composition according to the present invention comprises: (A) at least one cyanic acid ester compound represented by formula (1); and (B) an epoxy resin. (In formula (1), R₁, R₂, R₃ and R₄ independently represent a hydrogen atom or an alkyl group having 1 to 10 carbon atoms, and may be the same as or different from one another; and n represents an integer of 1 to 50.)

(57) 要約: 本発明は、低吸水性を有するだけでなく、吸湿耐熱性、難燃性、溶剤溶解性にも優れるプリント配線板を実現し得る樹脂組成物の提供を目的とし、これを用いたプリプレグ及び単層あるいは積層シート、並びに前記プリプレグを用いた金属箔張り積層板やプリント配線板等を提供する。本発明の樹脂組成物は、下記式(1)で表される1種又は2種以上のシアン酸エステル化合物(A)及びエポキシ樹脂(B)を含有する。(式(1)中、R₁、R₂、R₃及びR₄は、水素原子又は炭素数1~10のアルキル基を示し、互いに同一の基であっても異なる基であってもよい。nは1~50の整数を示す。)



WO 2015/060266 A1